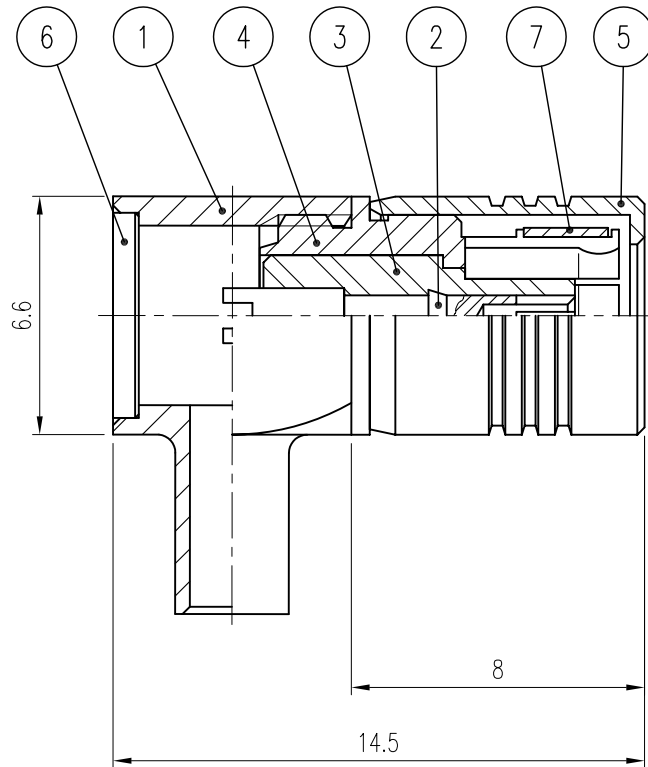


ST	기	정	수	정	내	용	수 정 내 용					
							부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일	
ST(기준)							△					
ST(개선)							△					



7	SPRING RING	1	BeCu	Nickel Plate	DSR00004-N45/1 (R3001) DSR00004-5/2 (R3001)
6	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00042-15/1 (L2003)
5	COUPLING CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00023-135/1 (K3004)
4	JACK	1	MBsBD	Gold Plate	DJA00034-N/1 (J3014)
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00342-N/1 (H3012)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00360-1345/1 (E3009)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00458-135/1 (D3052)

대체가능재질	품번		품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 1999. 2. 26.					 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인							
재질	검도				도명	SMB-L-085		
	재도							
열처리	작성부서 연 구 소					A4	도번 CN00203-7/1 K315-169-000	
보호피막처리	적도 5/1		단위 mm	총량				